

2026年3月期 第2四半期決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2025年11月6日

Contents

- 01 2026年3月期 第2四半期 連結業績**
- 02 2026年3月期 連結業績予想**
- 03 中期経営計画の進捗**

01

2026年3月期 第2四半期 連結業績

2025/上 実績（1）

業績サマリー

■ 売上高・利益

➤ 前年比 増収増益

売上高 423億円（16%増）、営業利益 75.7億円（32%増）

SPE分野が増加、特に半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 業績予想

➤ 通期業績予想、年間配当予想を上方修正

売上高 835億円、営業利益 125億円、ROS 15.0%、配当 238円

■ 受注高

➤ 受注は回復基調

受注高 412億円、前年比 11%増加、前下期比 25%増加

特に生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。

■ 受注残高

➤ 2025年9月末 475億円

2025/上 実績 (2)

業績結果 (対前年)

(単位：億円)

	24/上	24/下	25/上 実績	対前年 増減率
売上高	364	445	423	+16%
営業利益	57.5	83.9	75.7	+32%
R O S	15.8%	18.8%	17.9%	+2.1pt
経常利益	55.5	84.3	73.7	+33%
当期純利益	41.0	62.3	53.2	+30%
受注高	369	328	412	+11%
F C F	34.3	3.4	-41.8	-76.1億円

* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

■ 売上高

前年比16%増収 (364億円 ⇒ 423億円)

- SPE分野が増加、FPD分野と流通機器分野が減少、全体として増収。

■ 営業利益

前年比32%増益 (57.5億円 ⇒ 75.7億円)

- SPE分野の売上増加により増益。

■ 受注高

前年比11%増加 (369億円 ⇒ 412億円)

- 半導体前工程は高水準であった前年に比べ減少、半導体後工程は引き続き好調に推移。

■ FCF

前年比76億円減少 (34億円 ⇒ -42億円)

- 研究開発新棟、部材調達の資金需要増。

セグメント別業績結果（対前年）①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

- 売上高 前年比 11%増 (234億円 ⇒ 259億円)
半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置が順調に推移、Siウェーハ向け装置も堅調に推移し増加。
FPD前工程では、低調で減少。
- セグメント利益 前年比 21%増 (36.9億円 ⇒ 44.8億円)
売上増加により増益。
- 受注高 前年比 16%増 (238億円 ⇒ 275億円)
半導体前工程では、マスク向け装置など増加するも、前年同期に好調であったロジック/ファウンドリ向け装置が減少し、半導体前工程全体では前年同期に比べ減少。保守・サービスが増加。
FPD前工程では、前年に比べ増加。

セグメント別業績結果（対前年）②

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

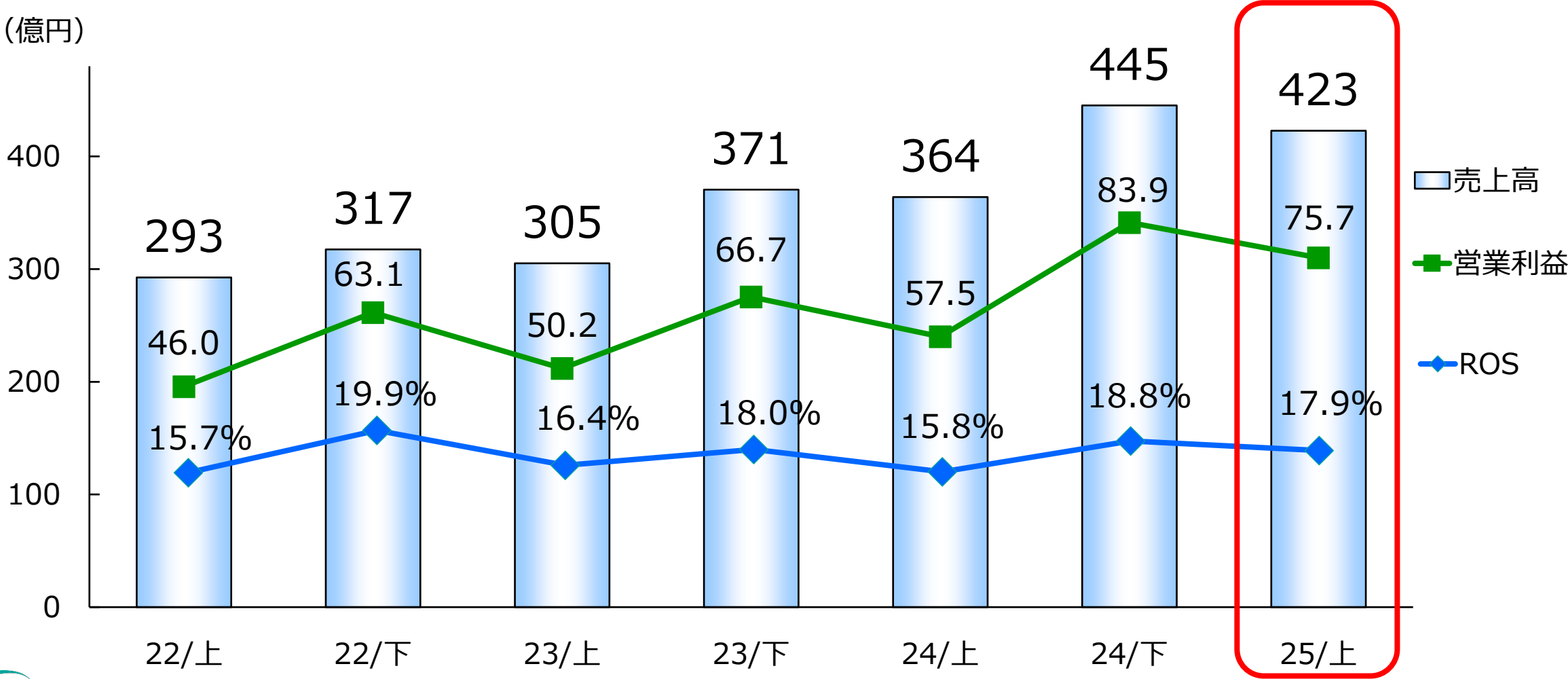
- 売上高 前年比 58%増（90億円 ⇒ 141億円）
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。
FPD後工程及び真空応用装置では、低調で減少。
- セグメント利益 前年比 103%増（16.6億円 ⇒ 33.7億円）
半導体後工程の売上増加により大幅増益。
- 受注高 前年比 22%増（94億円 ⇒ 114億円）
半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

2025/上 実績 (5)

売上高・利益・ROS

ROS 17.9%

(億円)

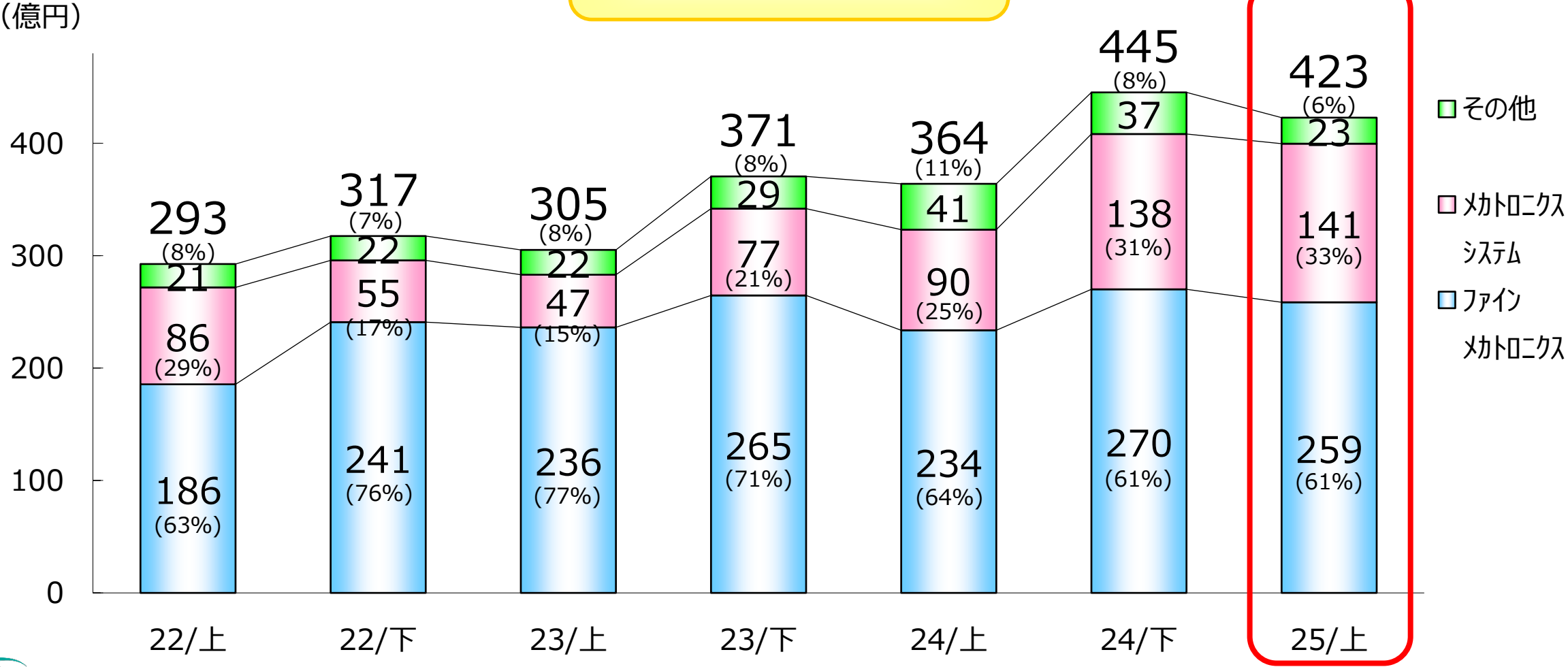


2025/上 実績 (6)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 61%
メカトロニクスシステム 33%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

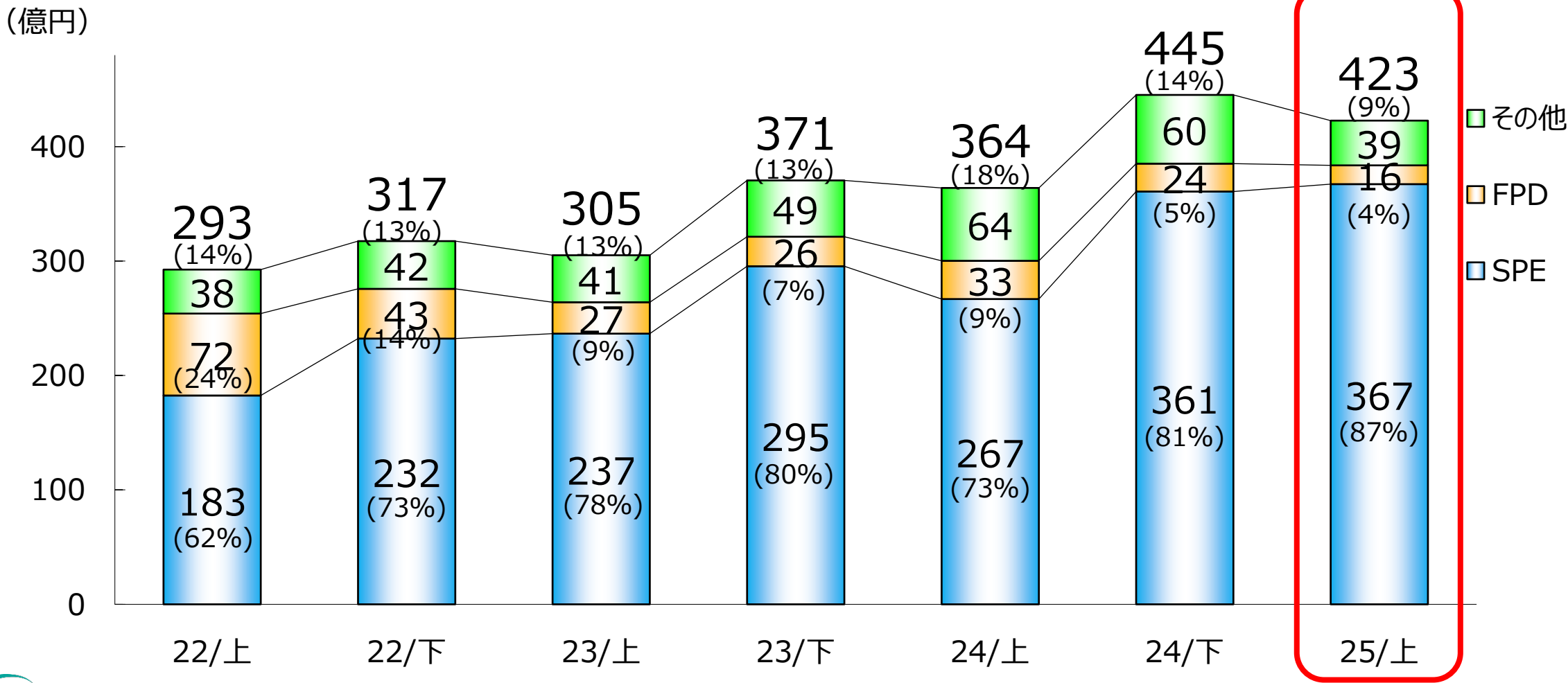


2025/上 実績 (7)

分野別売上高

SPE分野 87%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

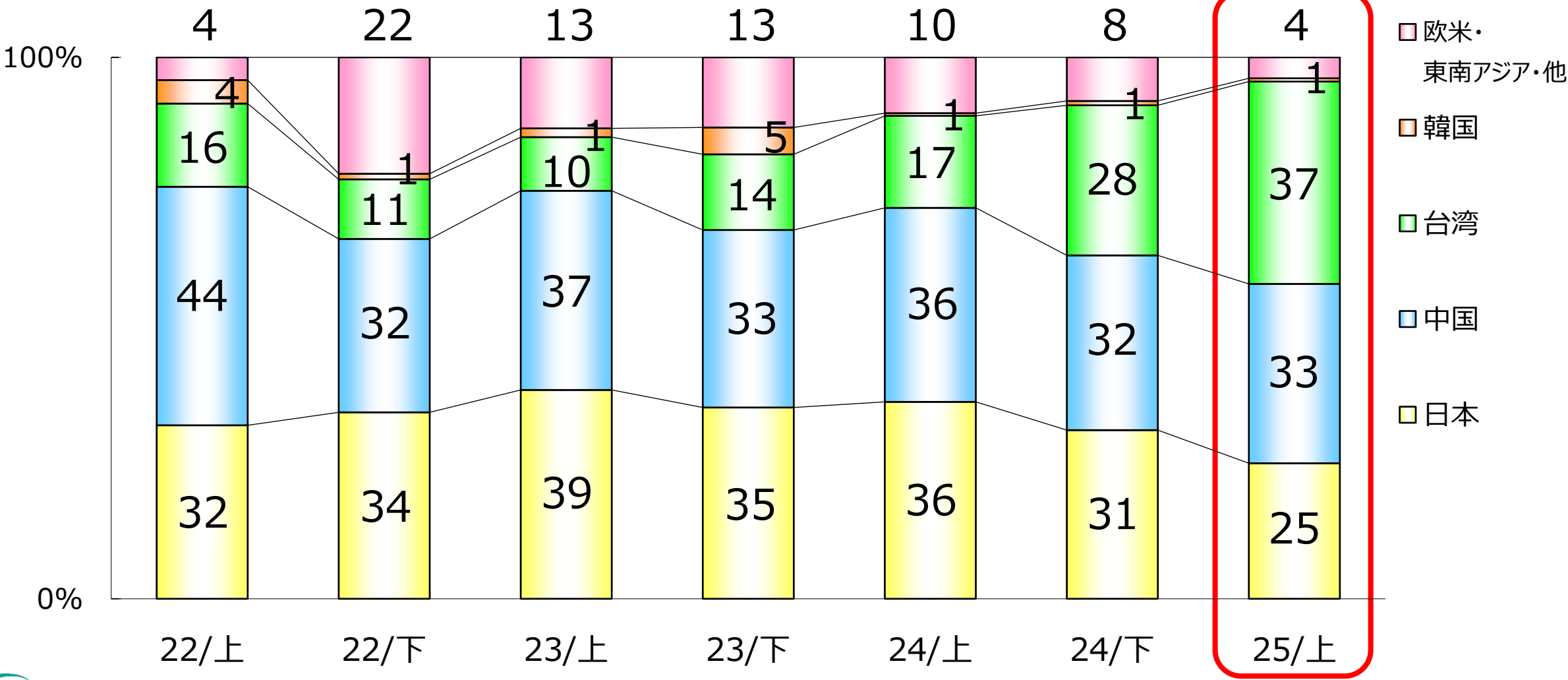


2025/上 実績 (8)

地域別売上高比率

海外向け75% (台湾37%、中国33%)

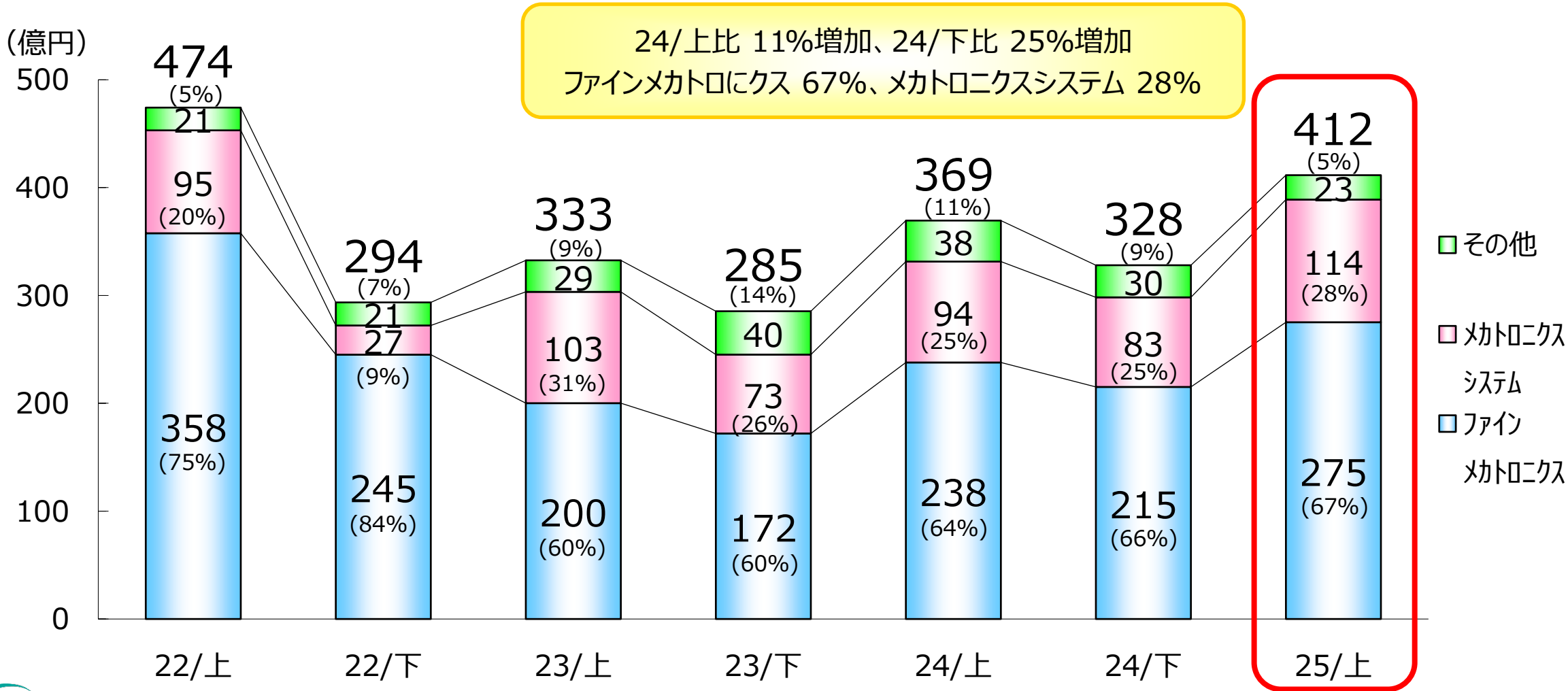
* 仕向地で区分



2025/上 実績 (9)

セグメント別受注高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

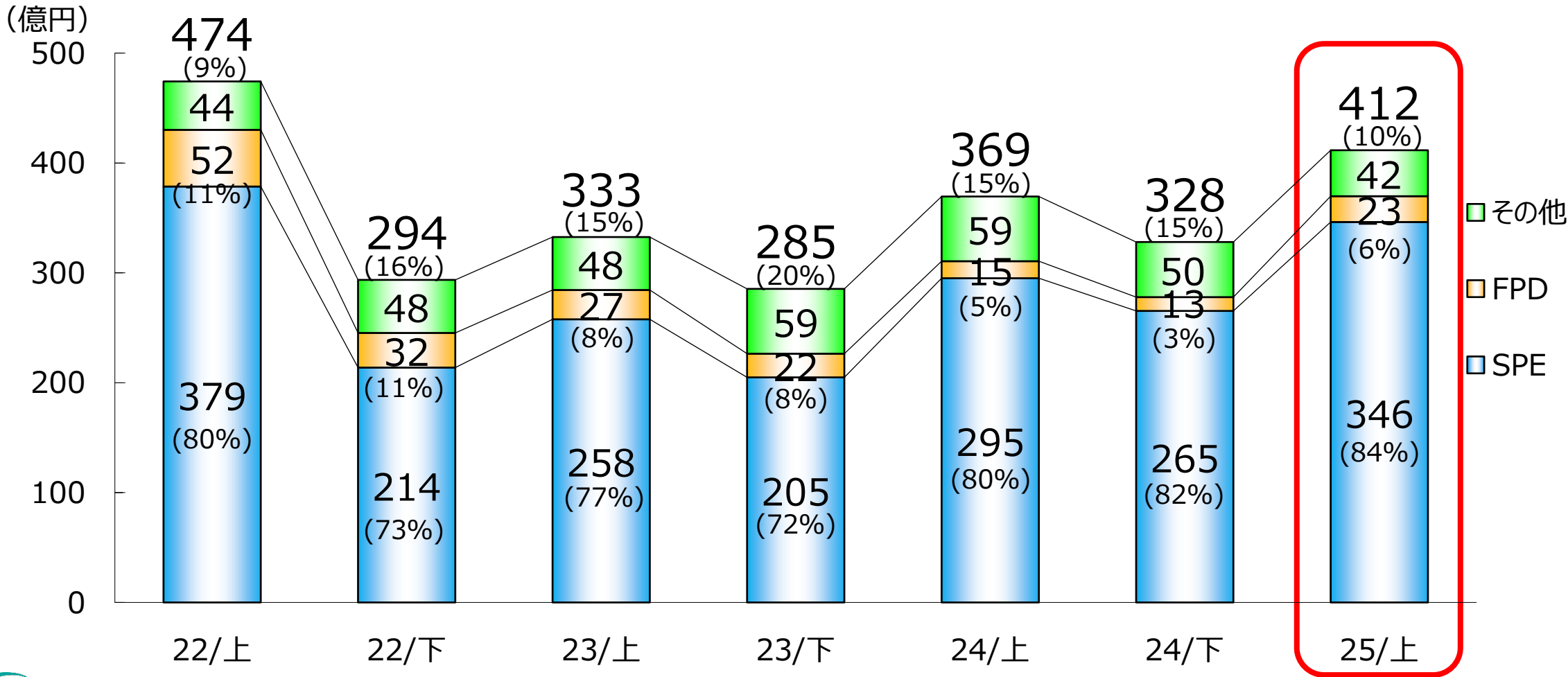


2025/上 実績 (10)

分野別受注高

SPE分野 84%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

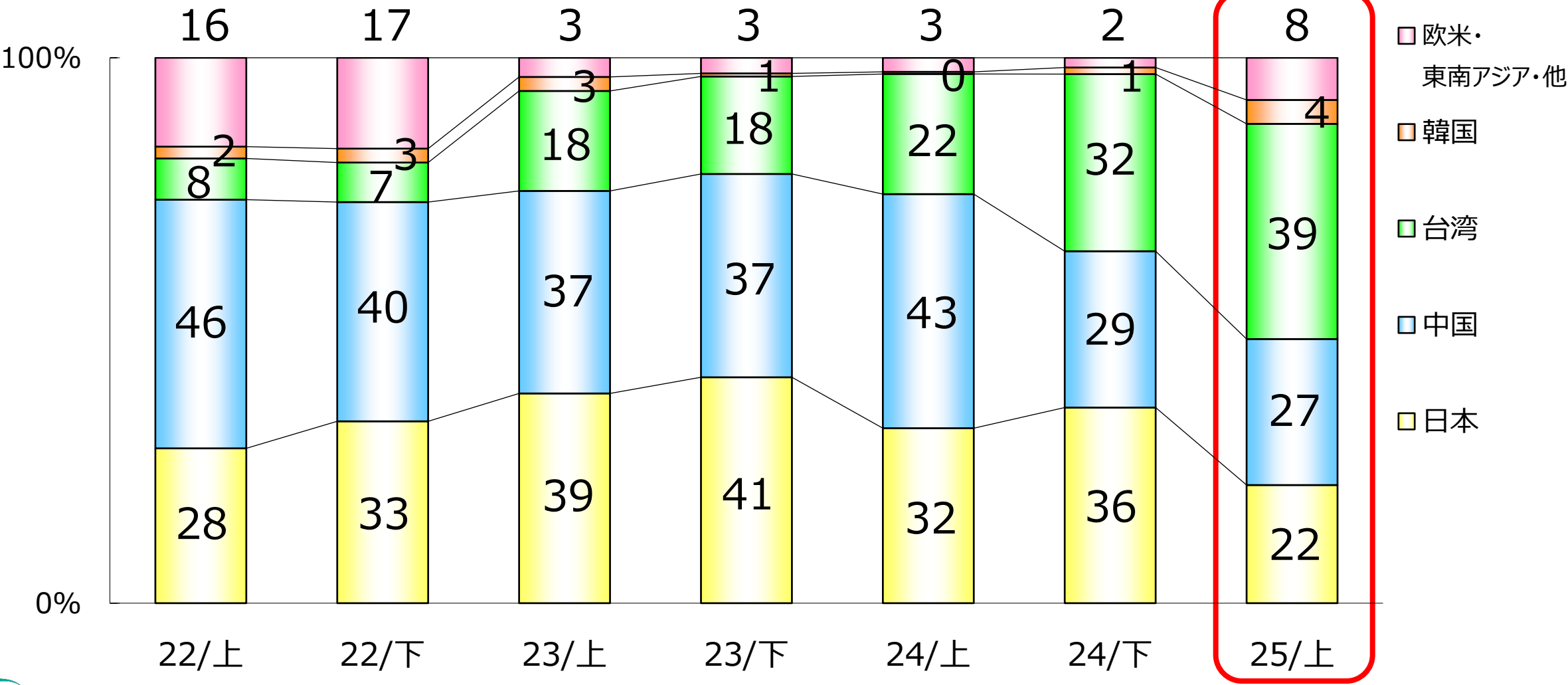


2025/上 実績 (11)

地域別受注高比率

海外向け78%（台湾39%、中国27%）

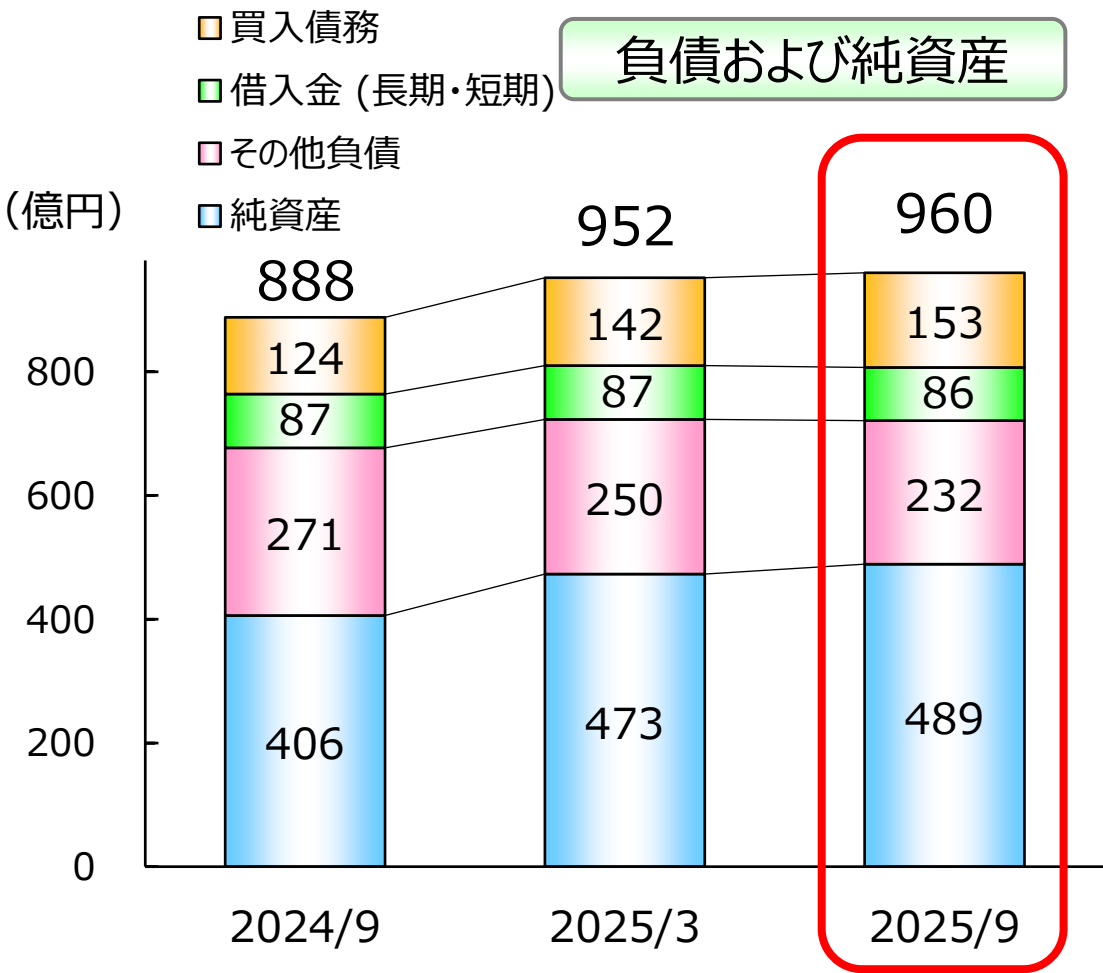
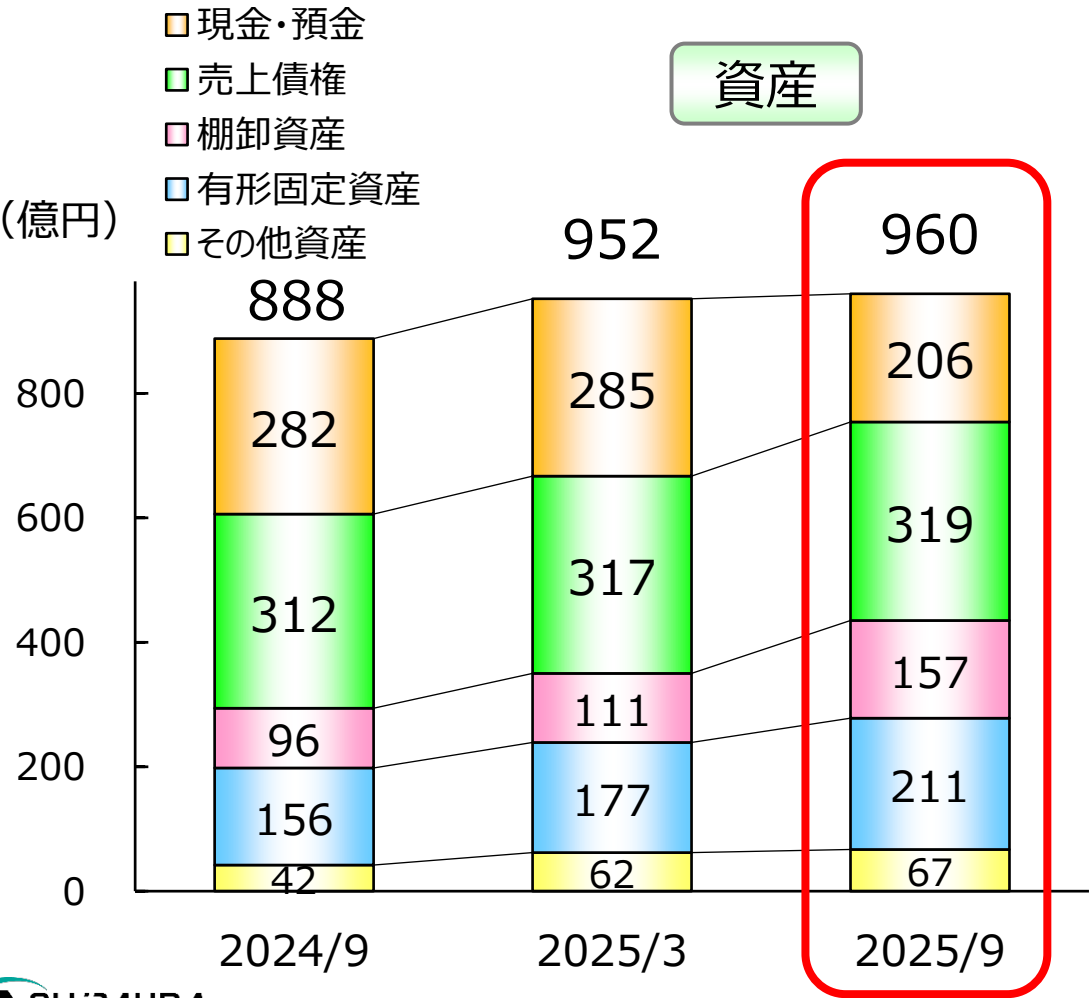
* 仕向地で区分



2025/上 実績 (12)

貸借対照表

自己資本比率 50% ('25/3) → 51% ('25/9)
D/Eレシオ 0.18倍 ('25/3) → 0.18倍 ('25/9)



02

2026年3月期 連結業績予想

2025年度 業績予想（1）

業績予想サマリー

■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、生成AI向けの投資継続。ロジック向けその他、メモリ向け設備投資も回復傾向。マスク向けは中国市場で引合い継続、Siウェーハ製造向け設備投資は回復途上、パワーデバイス市場は引き続き低調。
- FPD業界は、依然として設備投資が低水準。
- 当社として中長期的には市場の伸長とともに成長を目指す。ただし、半導体輸出規制強化、米国関税に継続注視。

■ 通期業績予想

- 2025年度業績は、業績進捗等を踏まえ前回予想から上方修正

売上高	800億円	⇒ 835億円（前回予想比+4.4%）
営業利益	105億円	⇒ 125億円（前回予想比+19%）
ROS	13.1%	⇒ 15.0%（前回予想比+1.9pt）
配当	200円	⇒ 238円（前回予想比+38円）

2025年度 業績予想 (2)

業績予想

2025年度は前回予想から
売上高、利益とも上回る見込み

*1: 2025年5月公表

(単位: 億円)

	2021 年度	2022 年度	2023 年度						2025 年度 予想	前回予想 *1
				24/上 実績	24/下 実績	2024 年度	25/上 実績	25/下 予想		2025 年度
売上高	493	610	676	364	445	809	423	412	835	800
営業利益	50.5	109.1	116.9	57.5	83.9	141.4	75.7	49.3	125.0	105.0
R O S	10.3%	17.9%	17.3%	15.8%	18.8%	17.5%	17.9%	12.0%	15.0%	13.1%
経常利益	48.8	105.1	116.1	55.5	84.3	139.8	73.7	47.3	121.0	101.0
当期純利益	29.8	92.0	87.9	41.0	62.3	103.3	53.2	35.8	89.0	75.0
R O E	12.8%	31.9%	24.5%	—	—	24.0%	—	—	17.5%	15.8%
F C F	77.9	32.0	36.8	34.3	3.4	37.7	-41.8	0	-41.8	6.0

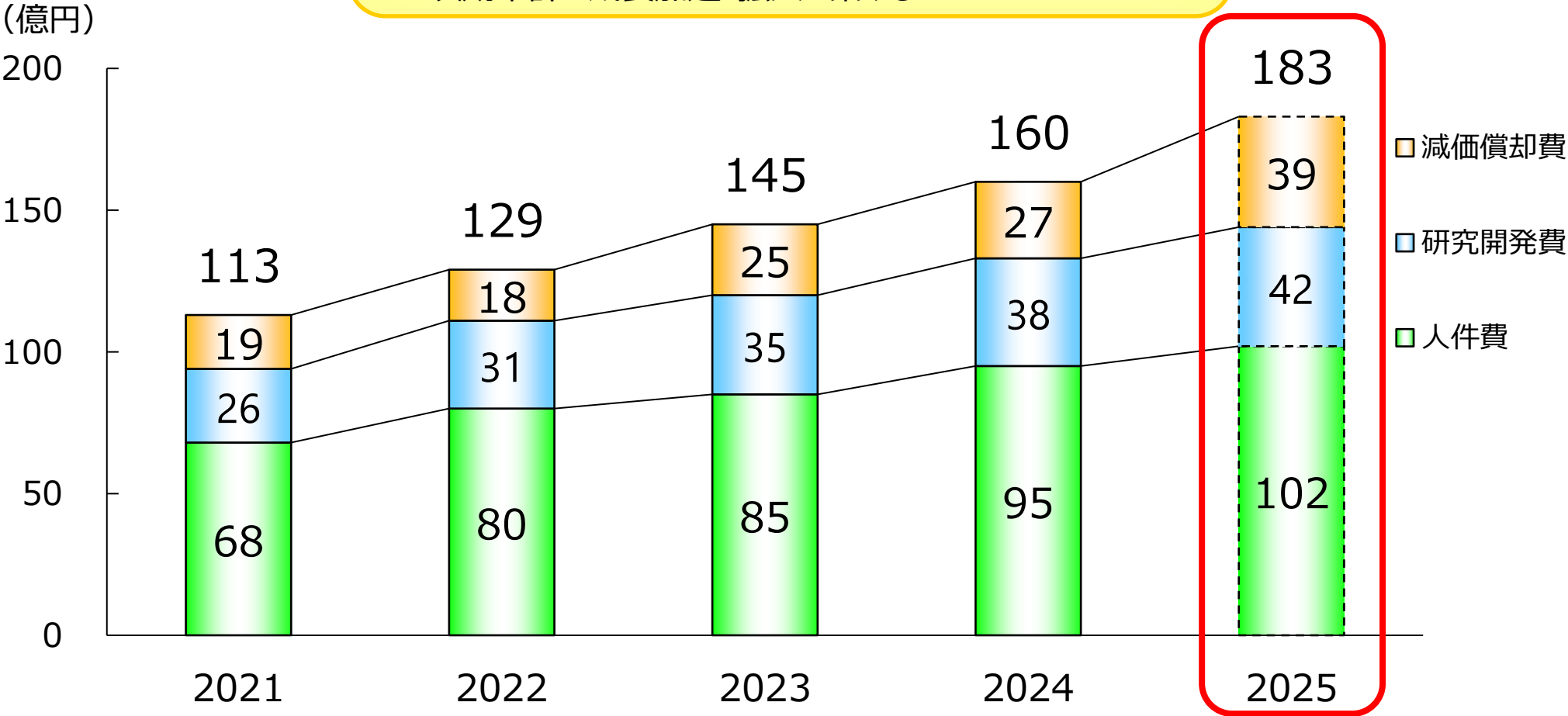
2025年度 業績予想 (3)

成長投資費用

開発評価機や開発新棟の減価償却費など、成長投資費用は
前年比 約23億円増加見込み

➡顧客の拡大や外部連携、新GNT製品の創出などで、
次期中計の成長加速・拡大に繋げる

* 関連ページ : p.32-36



2025年度 業績予想（4）

配当予想

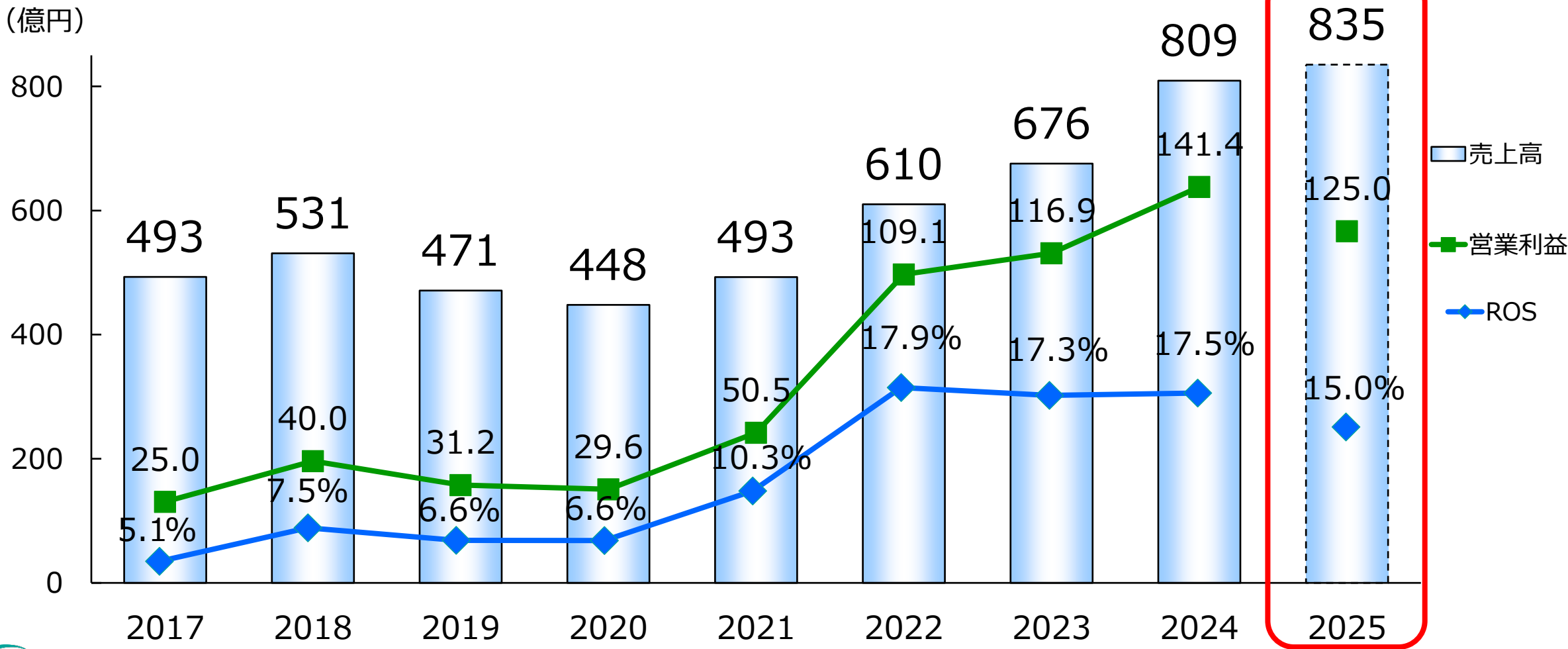
当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。
2025年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は前回予想から38円増配の238円（配当性向 35.1%）を予定しています。

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想（2026年3月期）	0円	238円	238円
前回予想（2026年3月期）	0円	200円	200円

（ご参考） 2025年3月期 年間配当278円

2025年度 業績予想 (5)

売上高・利益・ROS

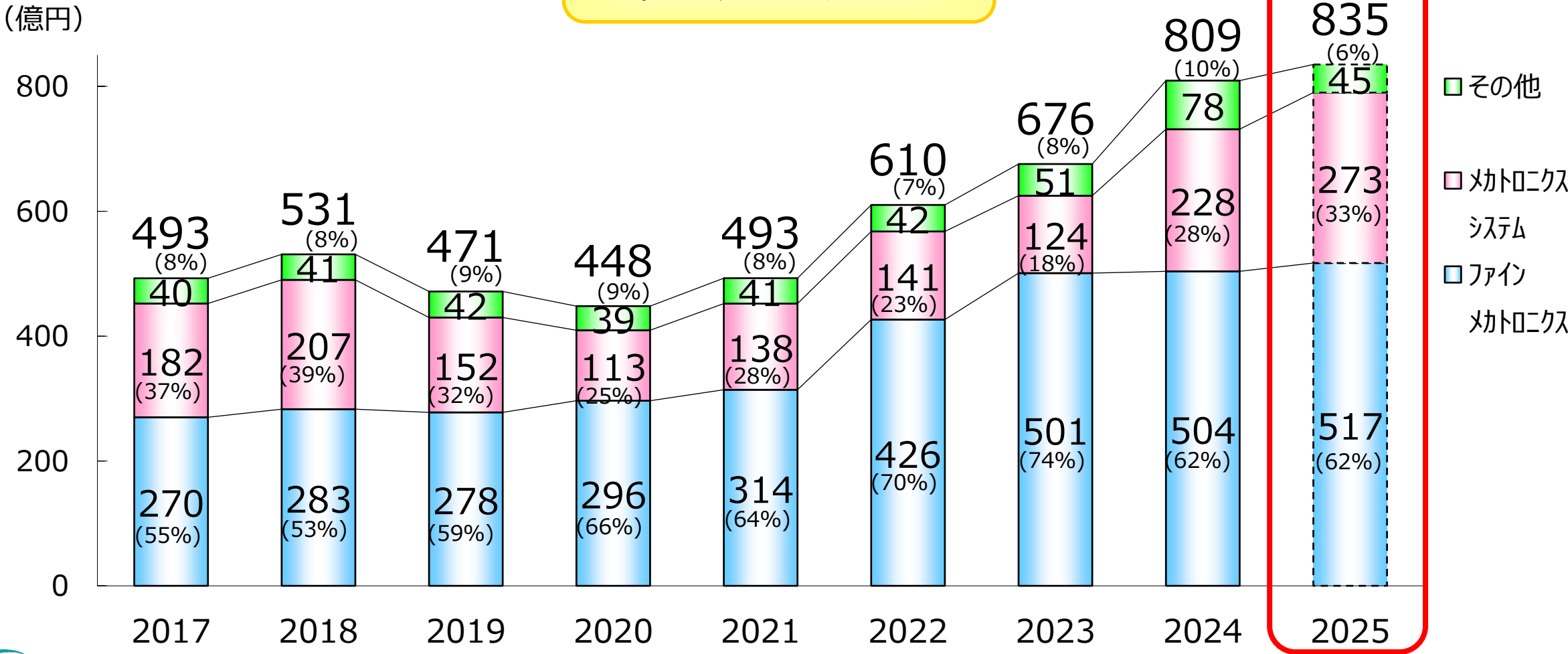


2025年度 業績予想 (6)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 62%
メカトロニクスシステム 33%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



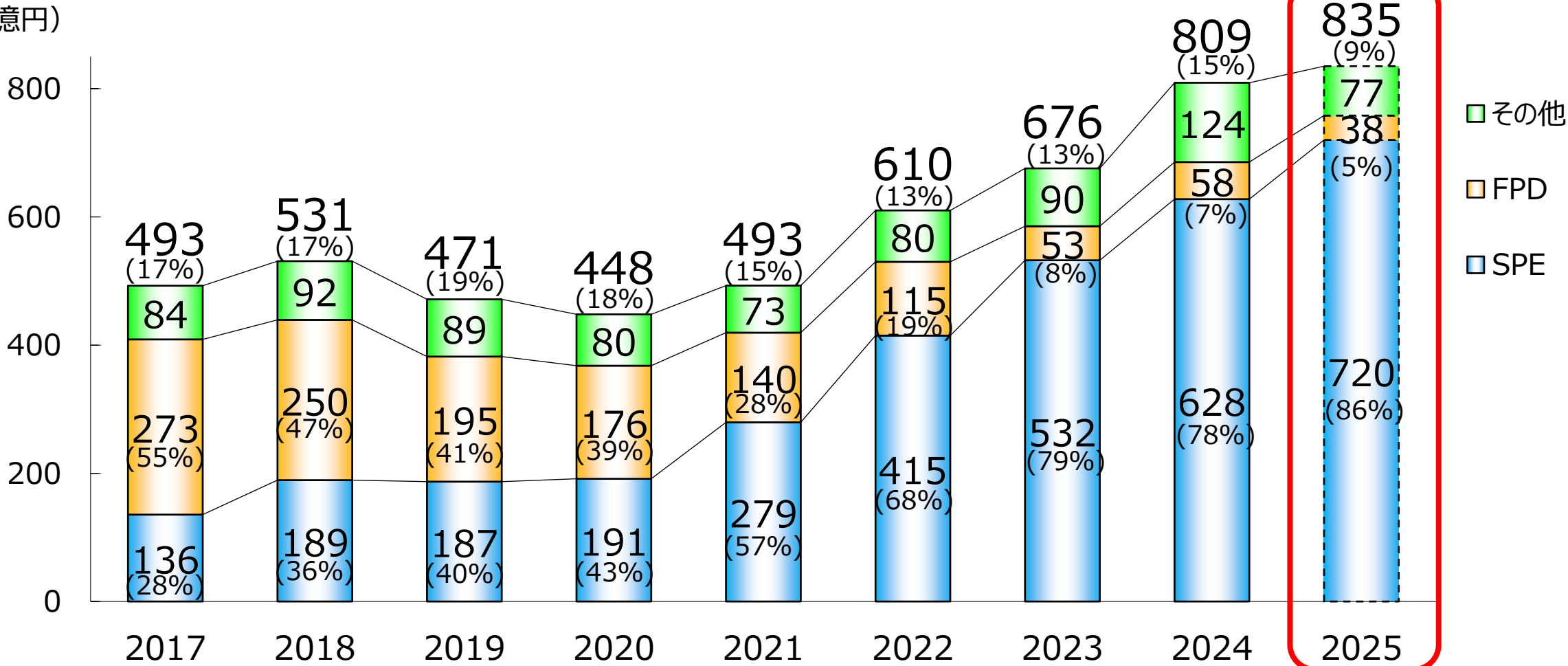
2025年度 業績予想 (7)

分野別売上高

SPE分野 86%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

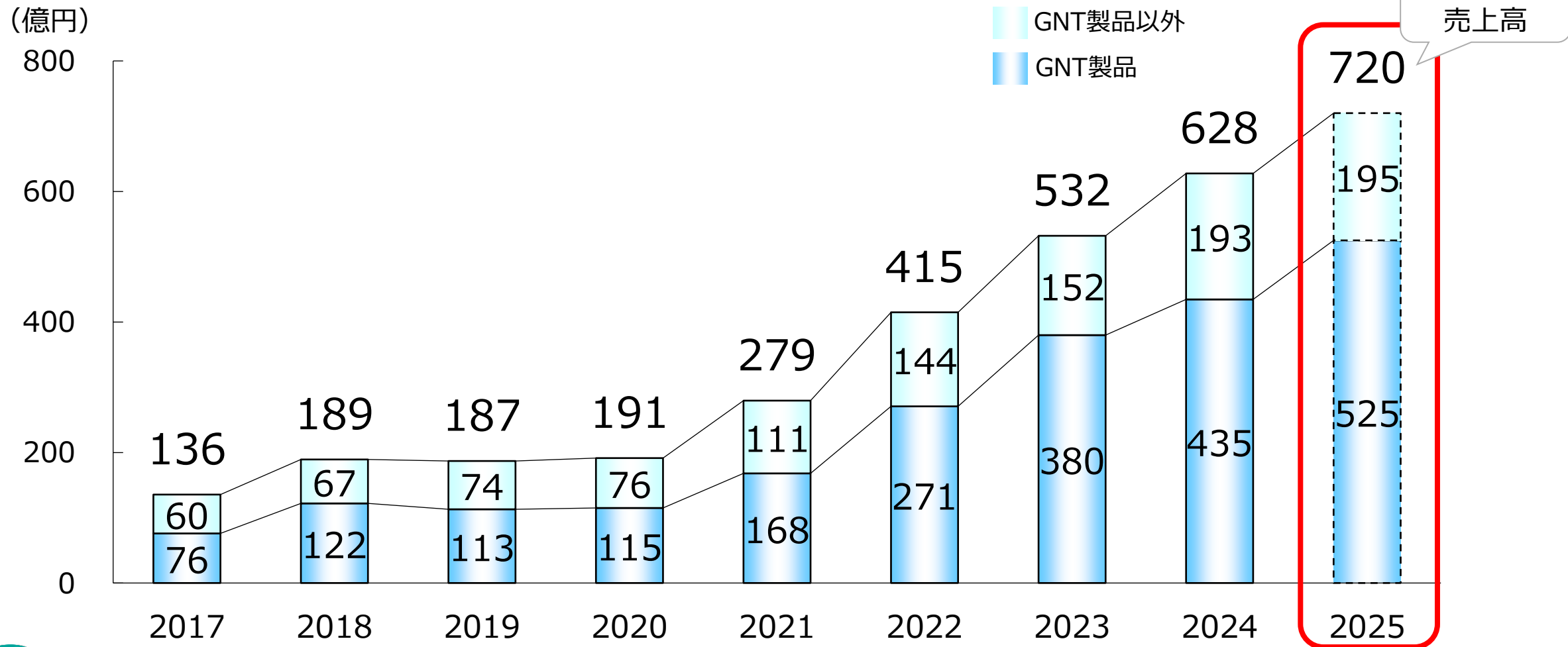
(億円)



2025年度 業績予想 (8)

SPE分野売上高

*GNT製品：当社グローバル ニッチトップ
対象製品群 (cf.p.31)

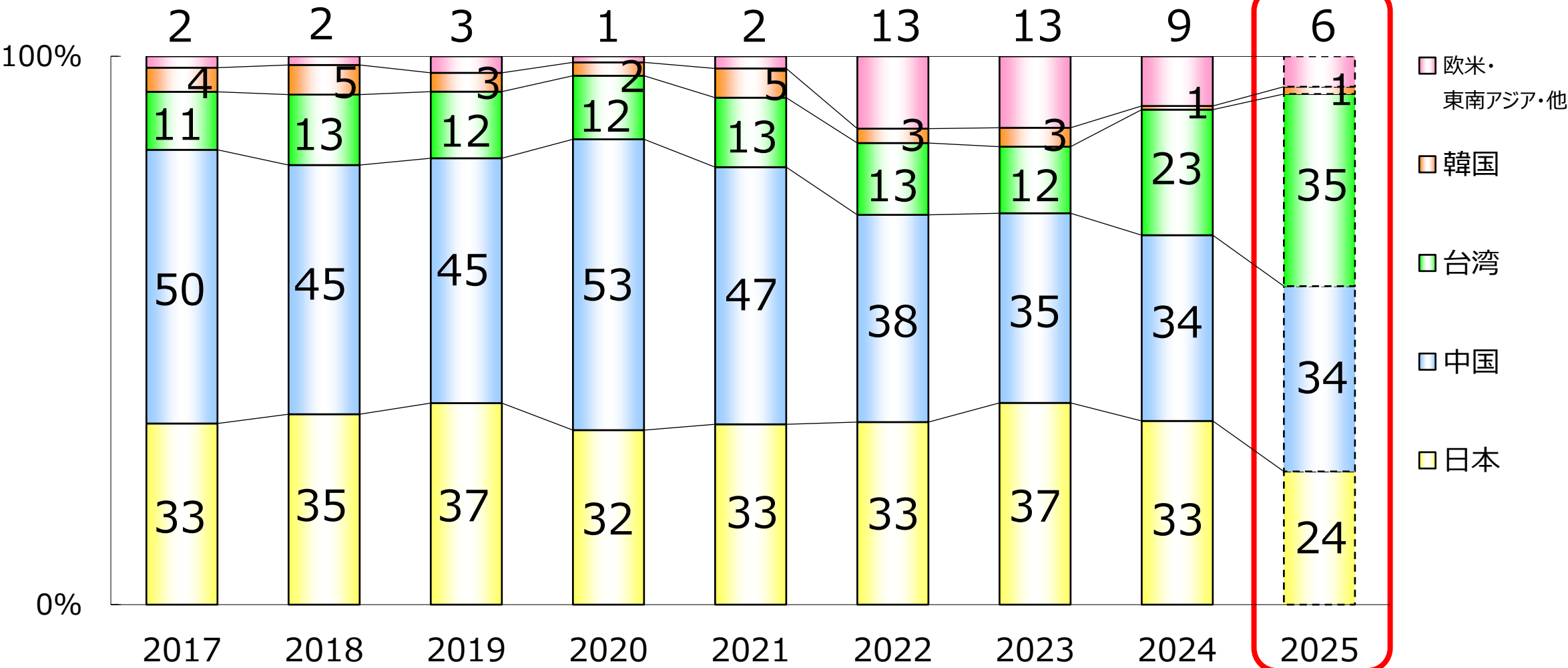


2025年度 業績予想 (9)

地域別売上高比率

海外向け76% (台湾35%、中国34%)

* 仕向地で区分



03

中期経営計画の進捗

長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」

当社として捉える社会変化・課題

市場

- ・IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

技術

- ・先端性の高い半導体の開発・製造
- ・技術者の育成、確保

環境

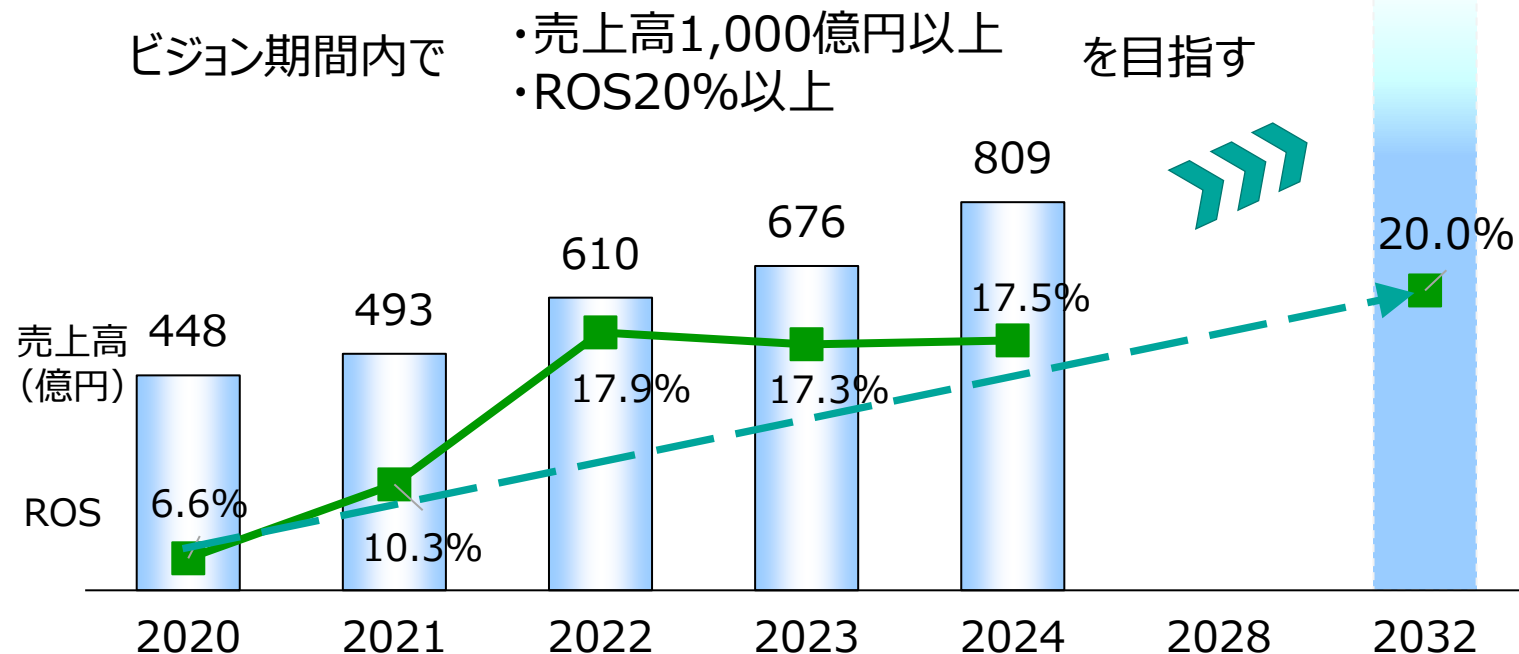
- ・カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- ・資源の有効利用

安定供給

- ・半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- ・求められる機能の多様化、高度化
- ・地政学的リスクへの懸念

10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**



中期経営計画方針

2023.4.1 – 2033.3.31

ビジョン達成

2023-2025 芝浦ビジョン2033 Phase.1

2026-2028
芝浦ビジョン2033
Phase.2

2029-2032
芝浦ビジョン2033
Phase.3

「持続的成長に向けた投資」を柱として、
次の成長に向けた土台強化を進め
再び営業利益100億円超を目指す

4
つ
の
柱

- ①SPE分野の更なる拡大
- ②持続的成長に向けた投資
- ③課題とニーズの把握
- ④マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

Phase.1の1、2年目とも
営業利益100億円を超過

最終年度2025予想も
営業利益125億円へ上方修正
土台強化を着実に実施し、
Phase.2へと繋げる

中期経営計画進捗（1）

中期経営計画の進捗

2025年度の売上・営業利益は中計公表値を上回る見込み
成長投資費用を次期中計の成長加速・拡大に繋げる

（単位：億円）

	2023	2024	2025	2023年5月 中計公表		
	年度実績	年度実績	年度予想	2023	2024	2025
売上高	676	809	835	590	680	700
営業利益	116.9	141.4	125.0	73.0	95.0	105.0
R O S	17.3%	17.5%	15.0%	12.4%	14.0%	15.0%
経常利益	116.1	139.8	121.0	-	-	-
当期純利益	87.9	103.3	89.0	-	-	-
R O E	24.5%	24.0%	17.5%	15.0%	17.0%	17.0%

中期経営計画進捗（2）

分野別市況と当社の方向性

S
P
E

- 前工程ではウェーハプロセス向けやシリコンウェーハ向けで堅調な引合い継続
- 後工程では引き続き生成AI市場向けが活況となる見込み
- 半導体輸出規制、関税等の状況は継続注視



実績のある装置、2024年度新製品の拡販、シェア拡大に注力
投資してきた研究開発設備や完成した研究開発新棟を活用し開発加速

F
P
D

- 引き続きTV、スマホ市場低調、ITパネル用大型サイズOLED投資計画も延期傾向、価格競争も激化
- AR・VR用途で期待されていたMicro-OLEDも投資計画延期傾向



前工程、後工程ともFPDで培ったコア技術をSPE分野へ展開
新規上市に向け開発加速中

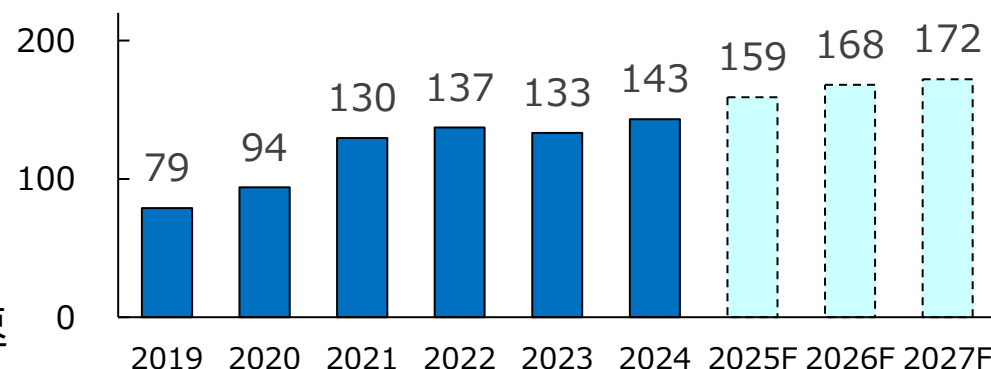
*1 出典：TechInsights Inc. 2025-9

*2 出典：カウンターポイントリサーチ 2025-10

いずれも暦年、グラフは当社にて作成

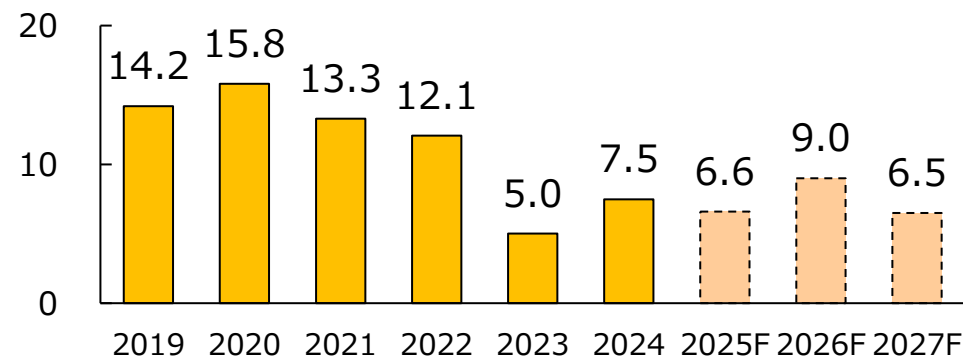
■半導体製造装置 売上高予測 *1

(単位：10億US \$)



■FPD製造装置 売上高予測 *2

(単位：10億US \$)



中期経営計画進捗（3）

SPE分野工程別 主要製品群

☞ 参照：製品・サービス

Siウェーハ製造



枚葉式Siウェーハ
洗浄装置

フォトマスク製造



フォトマスク
エッチング装置



フォトマスク
洗浄装置

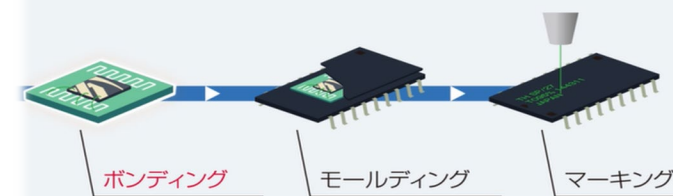
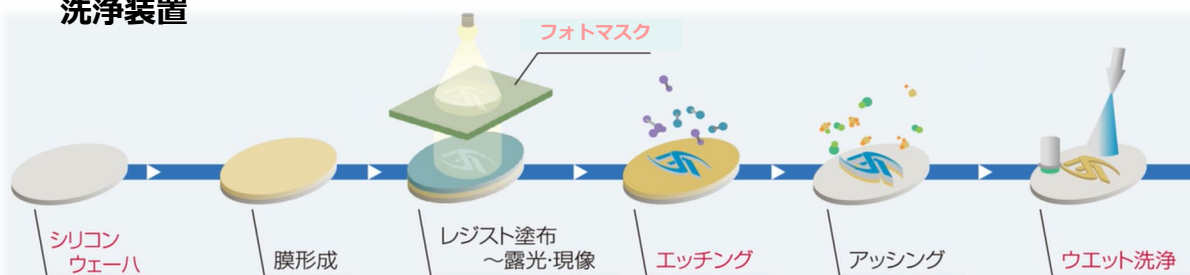
モジュールプロセス



超高精度
ハイブリッドボンダ



ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンダ



その他の注目製品



パネル用ウェットスピン装置
SHIBAURA



FOSB/FOUP
洗浄装置



高温リン酸
エッチング装置

ウェーハプロセス

- 引き続き4工程の製品群をGNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出



高精度2.5Dボンダ



高精度PLPボンダ

* いずれも環境調和型製品

* 当社グローバル ニッチトップ対象製品群（GNT製品）が属す4工程（掲載機種は一例）

中期経営計画進捗（4）

前工程トピックス

参照：半導体製造装置 前工程

ウェーハプロセス

ロジック／ファウンドリ
(CPU、GPU等)
メモリ (DRAM)

フォトマスク製造

ブランク、PSM、
EUVマスク
次世代EUVマスク

Siウェーハ製造

Si、SiC、
各材料のウェーハ

その他の注目製品

FOSB／FOUP

パネルデバイス



- 枚葉式高温リン酸エッチング装置は先端デバイス製造において量産に適用
加えてレガシー製品の受注伸長、引続き顧客拡大、工程拡大に注力
- 先端デバイスに対応した優れた温度制御性の新たな加熱技術を展開、
顧客とのフィールド検証を開始予定
- 最先端向け装置の展開に向けてフィールド検証へ移行
- レガシー製品向けのさらなるシェア向上を目指し、拡販への取り組み継続
- 更なる微小パーティクル低減に向けたウェーハ凍結洗浄プロセス開発を推進、
26年度内の上市に向けて顧客とのフィールド検証中
- Siウェーハで培った洗浄技術をSiCウェーハ市場へ展開、26年の上市とパワー
デバイス市場回復に備え、プロセス開発を加速
- デバイスメーカ、Siウェーハ製造メーカー向けFOSB／FOUP洗浄装置の顧客
拡大に注力
- 次世代半導体パッケージ関連メーカー向けにパネル用ウェットスピン装置を上市



高温リン酸
エッチング装置



フォトマスク
洗浄装置



枚葉式
Siウェーハ
洗浄装置



FOSB／FOUP洗浄装置

中期経営計画進捗（5）

後工程トピックス

👉 参照：半導体製造装置 後工程

モジュールプロセス



ハイエンド2.XD
パッケージボンダ
TFC-6500-W series
2.5D、GPU、AIチップ

- 豊富な販売実績を誇るTFC-6500の後継・上位機種、実績好調
- 接続基板（インターポーザ）の進化に対応した新型ボンダ開発中



ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンダ
TFC-6600
FO-WLP、APモジュール

- TFC-6100の後継・上位機種として高評価、多くの受注を獲得
- 多様なパッケージに対応する優れたオプション機能を鋭意拡充中



超高精度ハイブリッドボンダ
TFC-6800
D2W-Hybrid、チップレット

- 従来比3倍の高い生産性を実現
- 前処理（洗浄、プラズマ）システムの研究開発進行中



高精度PLPボンダ
TFC-9300
パネルレベル、ブリッジ実装

- 大型基板へ高精度実装、高い技術力と実績でPLP市場へ販売展開
- 今後の成長が期待されるPLP市場動向とニーズの確実な把握

中期経営計画進捗（6）

新製品紹介（前・中工程）

次世代半導体パッケージ向けの高清浄度洗浄や、エッチングなど各種ウェット処理に適用可能なパネル用スピン装置

■ ニーズ

次世代半導体パッケージでは、大型の角型ワークを対象としたウェーハ前工程レベルの処理性能が求められている。

■ 用途

サーバや生成AIに用いられるGPU/CPUの2.XD製品

■ 特長

- ① 多様なワーク対応(600mm角や300mm角ほか、有機基板、ガラス、Si等)
- ② ウェーハ前工程レベル × 大型の角型ワークのプロセス技術
- ③ 開発・研究向けの柔軟なユニット構築、量産展開対応

次世代半導体パッケージ向け
パネル用ウェットスピン装置
「PD series」



中期経営計画進捗（7）

新製品紹介（後工程）

サーバや生成AIに用いられるGPU/CPUの高精度2.5D市場で豊富な販売実績を誇る
TFC-6500の後継・上位機種

■ ニーズ

サーバなどに用いられるGPU/CPUでは、高精度な実装が求められる。
また、生成AI用2.XDパッケージではダイの実装数が増え、
マルチダイプロセスの需要が高まっている。

■ 用途

サーバや生成AIに用いられるGPU/CPUの2.XD製品

■ 特長

- ① 高精度実装の実現かつ安定性の向上
- ② マルチダイプロセスの対応

ハイエンド 2.XDパッケージボンダ
「TFC-6500-W series」



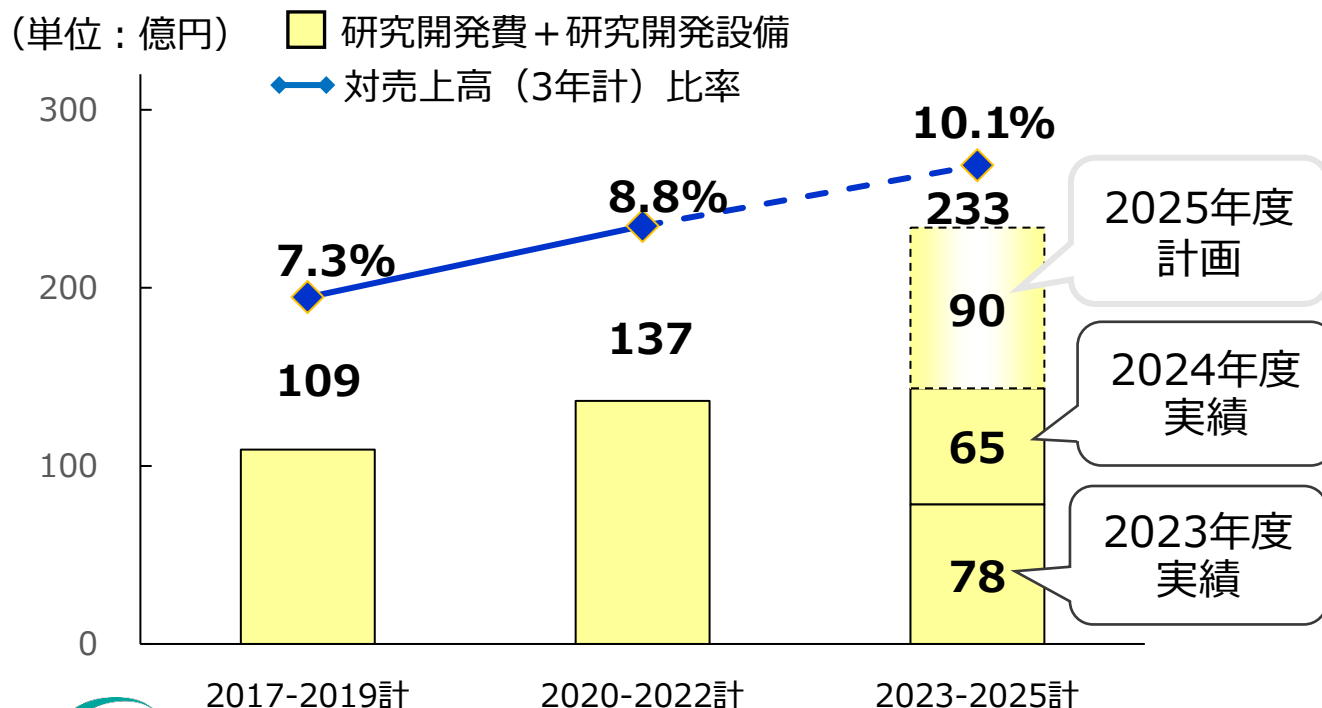
中期経営計画進捗（8）

持続的成長に向けた投資

■ 研究開発費・研究開発設備

- 評価機への投資増加に伴い、3年間204億円から233億円に増額見込

■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移（中計期間別）



サステナビリティ経営関連トピックス

■ あるべき姿達成に向けた取組みを継続

- 事業を通じて展開するマテリアリティより（抜粋）

環境調和型
製品の開
発・提供で
グリーン社
会に貢献

環境調和型製品売上高比率
目標85%以上

* 2024年度は対売上高96.3%

関連する
SDGs目標



継続
取組み例

- ・環境調和型製品新規創出
- ・水や薬液使用量の削減
- ・環境調和型製品に寄与する技術検討

- 9月に統合報告書を発行
- コーポレートサイトのリニューアル完了済
サステナビリティコンテンツを拡充

👉 統合報告書 2025

中期経営計画進捗（9）

Photo electron Soul社との提携（2025年8月28日公表）

■ 資本業務提携について合意

- Photo electron Soul社開発「半導体フォトカソード型電子ビーム生成システム」の量産・メンテナンスに関する資本業務提携の合意
- 微細化が進む半導体デバイスの欠陥検査等での活用が期待されている本電子ビーム生成システムの早期量産体制構築に貢献
- 先端向け半導体製造装置メーカーとしての技術、知見、ノウハウ、製造環境等を活かせるほか、サービスネットワークを活用したメンテナンス面でも連携

本電子ビーム生成システムの半導体業界での展開・発展を支えることで、半導体製造における歩留まり改善等課題解決への貢献を目指す

➤ 同社半導体フォトカソード型電子ビームシステムの主な特長

- ◇ 工業用途の電子ビーム生成源としてはおおよそ半世紀ぶりの新方式
- ◇ 例えば半導体デバイスの検査では、これまで見えなかったデバイス構造（深穴・深溝）の底部・深部まで非破壊で検査・解析可能、微小トランジスタの電気的特性の非接触での検査・解析にも応用されることが期待される



出典：Photo electron Soul社
ホームページ

株式会社Photo electron Soul会社概要（名古屋大学発スタートアップ企業）
所在地：愛知県名古屋市
事業内容：電子ビーム発生装置及び素子の研究、開発、製造及び販売
URL：<https://photoelectronsoul.com/>



この先もずっと、
人と技術で
社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、

「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で

お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、

豊かな社会の実現を支えてまいります。

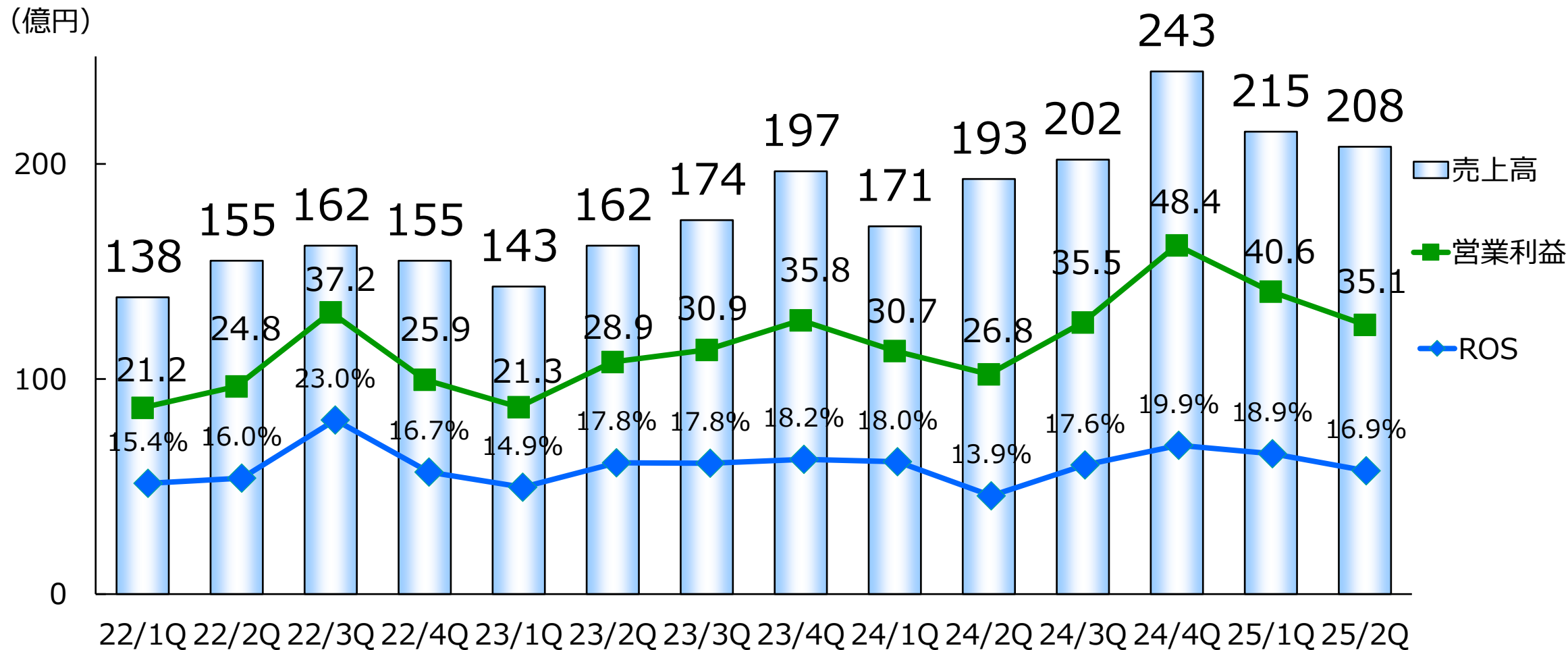
見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

Appendix

四半期推移 (1)

売上高・利益・ROS



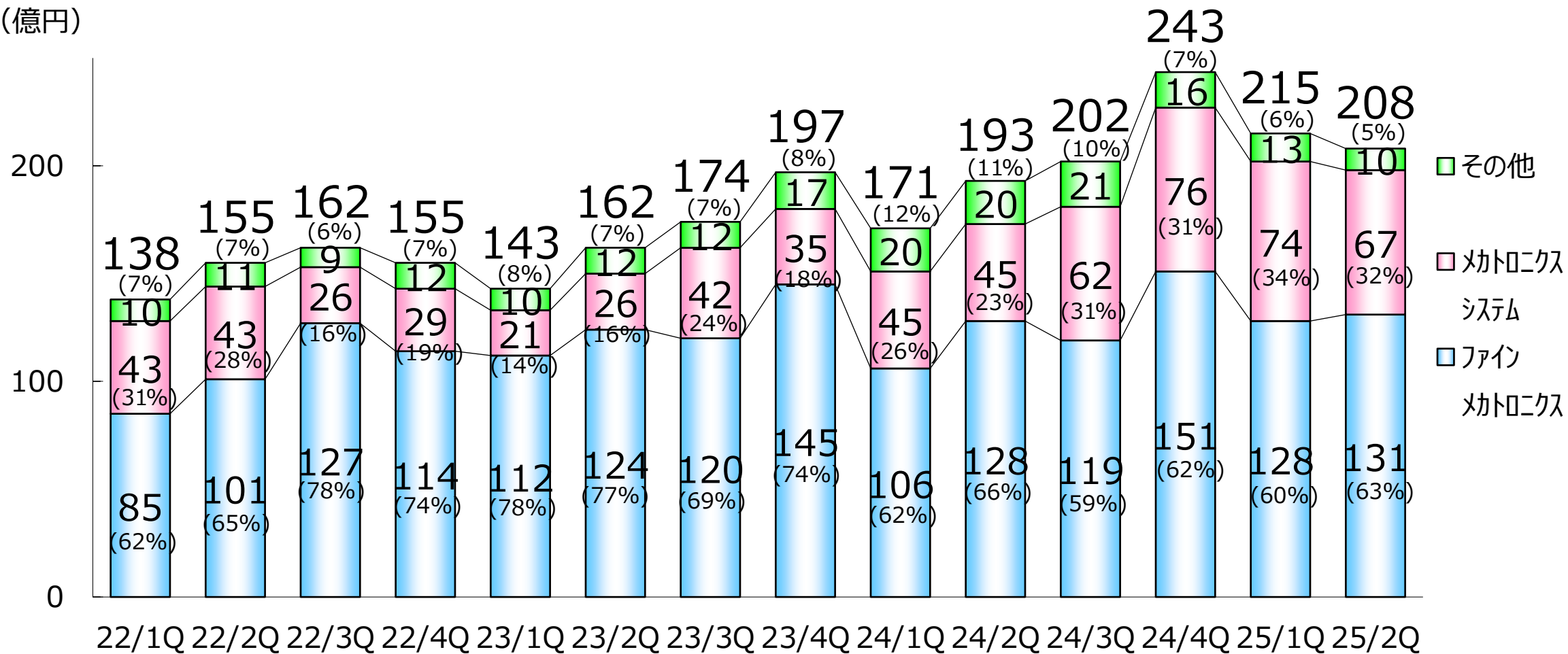
四半期推移 (2)

セグメント別売上高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置

エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)

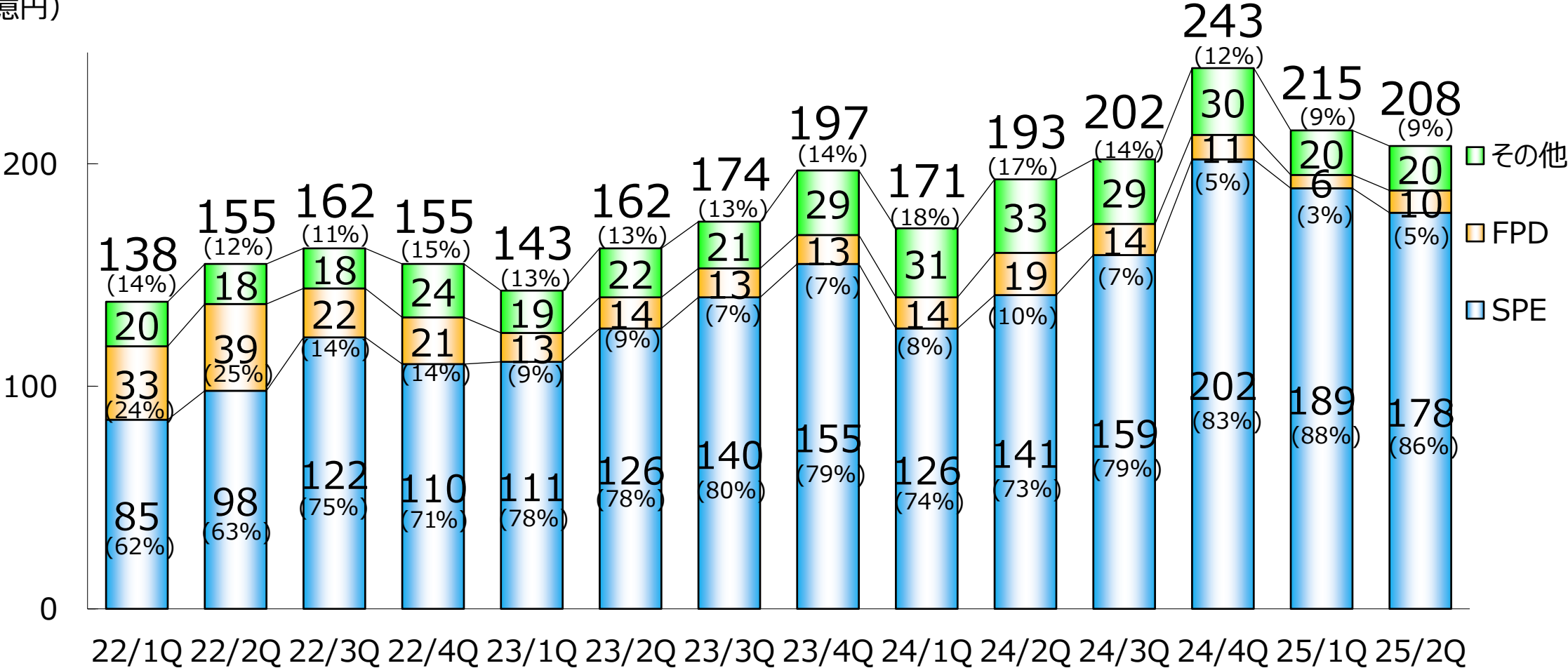


四半期推移 (3)

分野別売上高

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

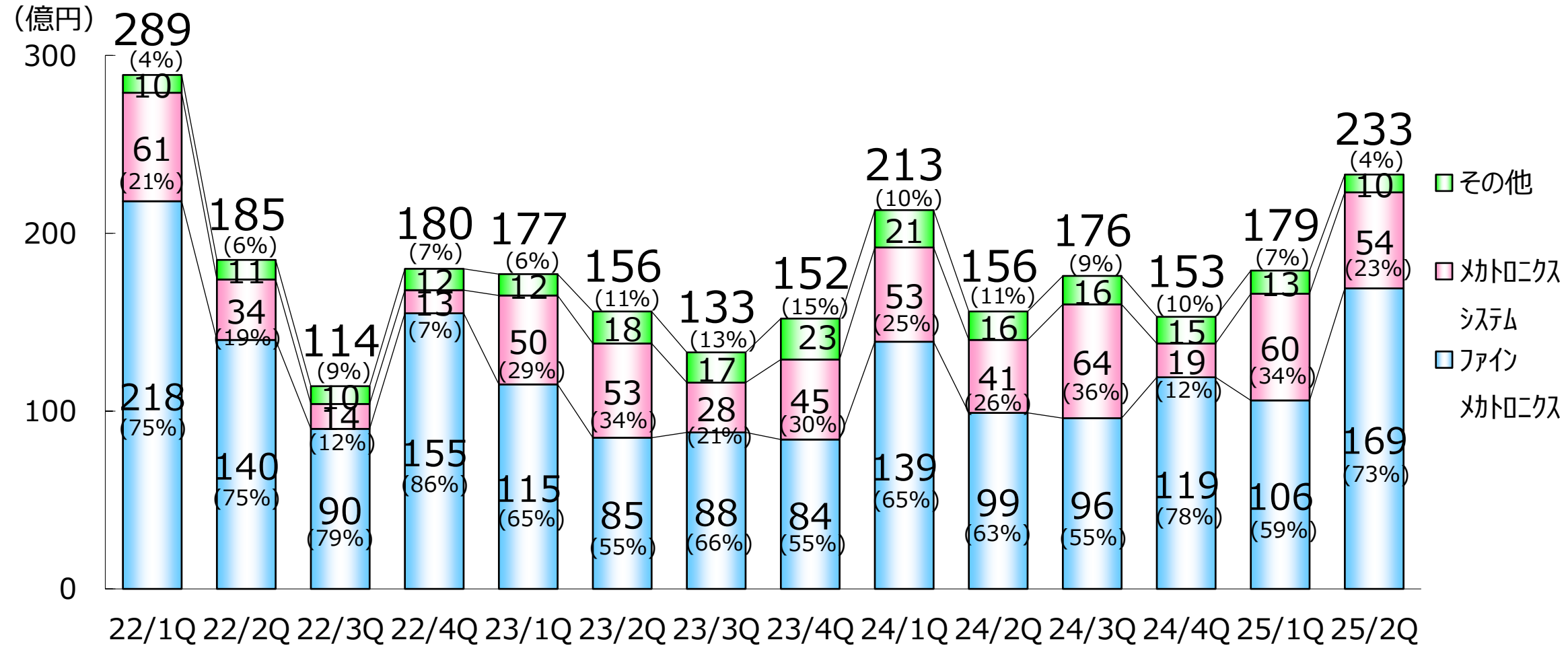
(億円)



四半期推移 (4)

セグメント別受注高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置
エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



四半期推移 (5)

分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

